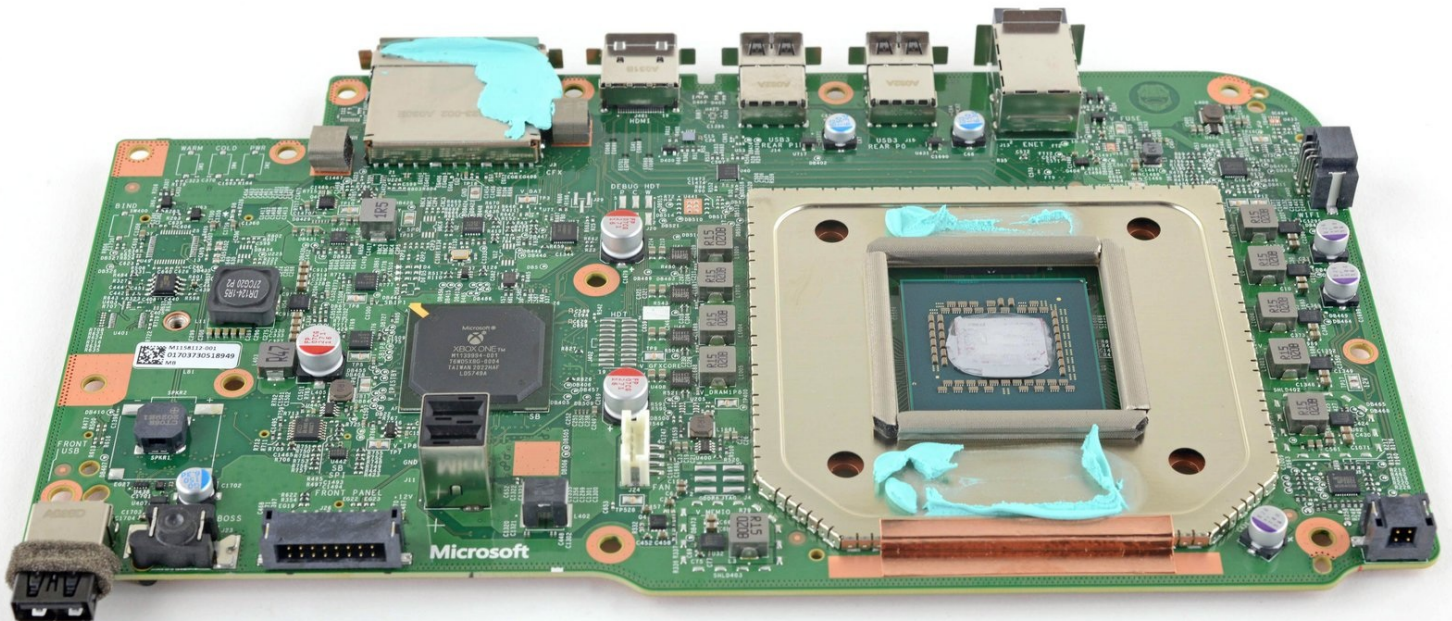




Xbox Series S マザーボードの交換

このガイドを参照して、Xbox Series S マザーボードを交換します。 ご注意:...

作成者: Robert Boyd



はじめに

このガイドを参照して、Xbox Series S マザーボードを交換します。

ご注意: ヒートシンクを取り外す際には、プレートとヒートシンクの間の放熱グリスを交換する必要があります。通常の放熱グリスは大きな隙間を埋めるようには設計されていないため、K5 Pro 粘着性サーマルペーストをしようしてください。APUには通常の放熱グリスをしようしてください。

外付けBluetooth、Wi-Fi、電源ボードの画像に一貫性がない部分がありますが、修理作業には影響しません。



ツール:

ピンセット (1)
T8トルクスネジ用ドライバー (1)
T10 トルクスドライバー (1)
スパッジャー (1)
1.5 mm マイナスドライバー (1)
放熱グリス(サーマルペースト) (1)
K5-PRO Viscous Thermal Paste (1)



部品:

Xbox Series S Motherboard (1)
Xbox Series S Heat Sink (1)
Xbox Series S Heat Sink X Clamp (1)

手順 1 — ステッカーを剥がします



⚠ この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。

- ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。

手順 2 — バックパネルのネジを外します



- T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。

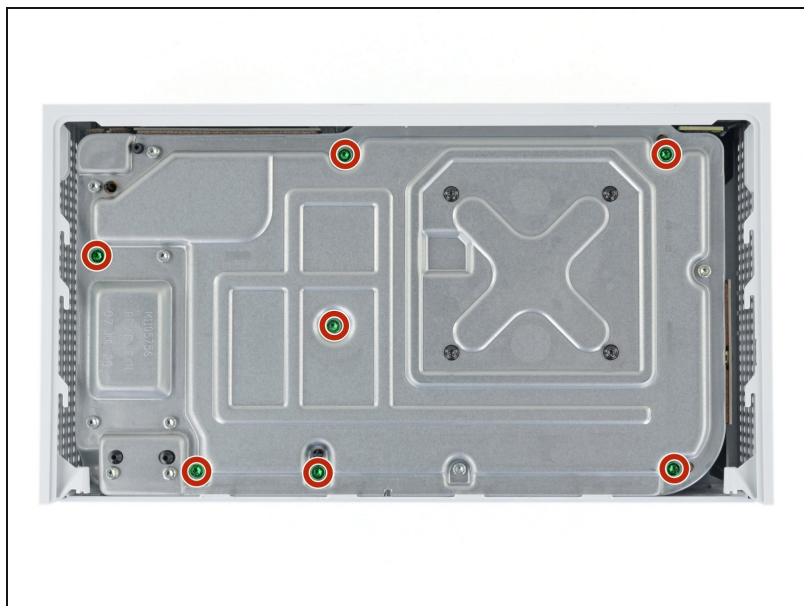
① この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。

手順 3 — 下部パネルを外します



- コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
- ① このスライドする作業によって、プラスチックケースのロットからクリップを外します。
- 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。

手順4 — プラスチックケースのネジを外します



- T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。

手順5 — プラスチックケースを外します



- Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
- コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
 - ① これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
 - ① バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。

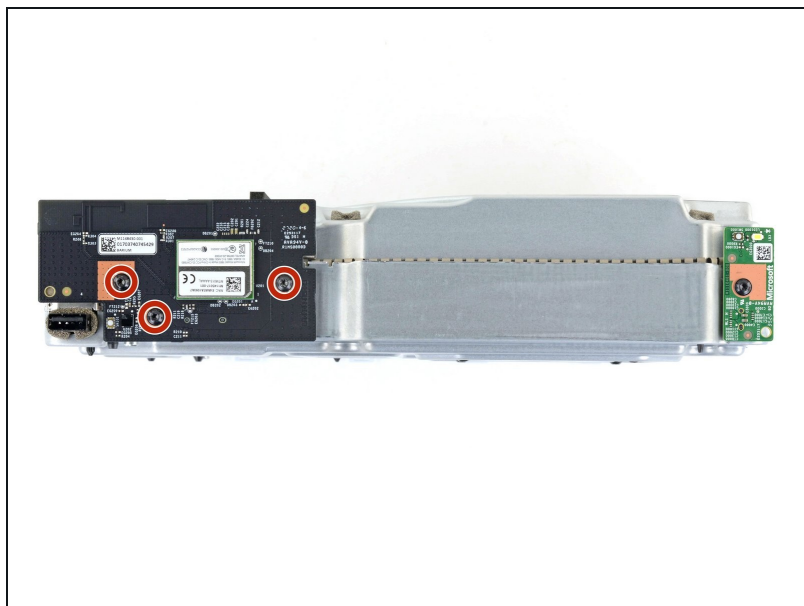
⚠ この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。

手順 6



- 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
 - ① この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
- シャーシからプラスチックケースを外します。

手順 7 — Bluetoothボードを外します



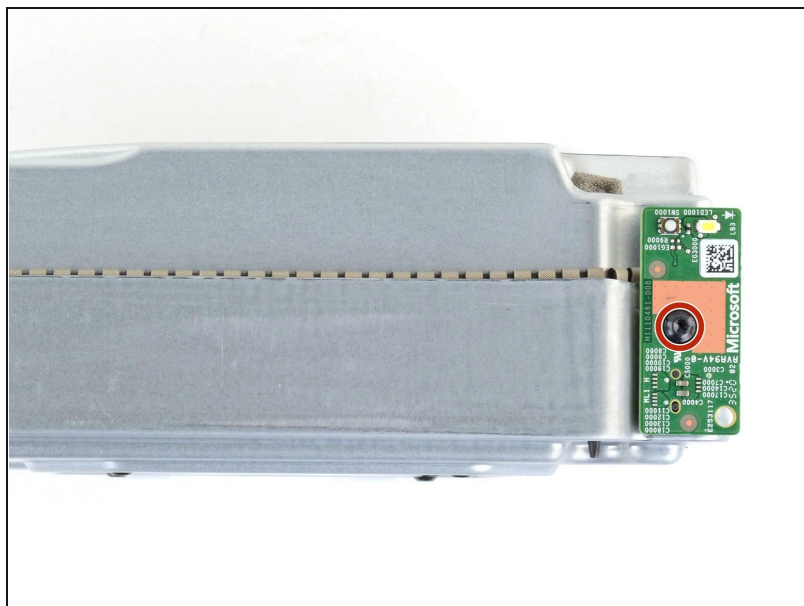
- T8トルクスドライバーを使って、Bluetoothボードをシャーシの長辺側に固定している9.5mm長ネジを3本外します。

手順 8



- スパッジャーを使って、Bluetoothボードをこじ開けて緩めます。
⚠ Bluetoothボードの側面もしくは底面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまうことがあります。
- Bluetoothボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。

手順 9 — 電源ボタンボードを外します



- T8トルクスドライバーを使って、電源ボタンボードをシャーシに固定している9.5mm長ネジを外します。

手順 10



- スパッジャーを使って、電源ボタンボードをこじ開けて緩めます。
⚠ コネクタを曲げてしまうことがあるので、電源ボタンボードの底からこじ開けないでください。
- 電源ボタンボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。

手順 11 — Wi-Fi ボードを外します



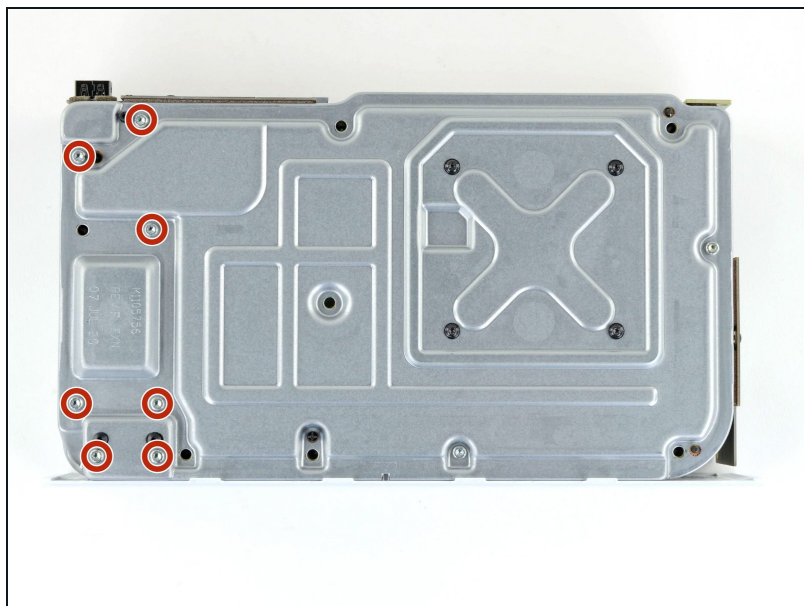
- T8トルクスドライバーを使って、カシスの短辺側にWi-Fiボードを固定している9.5mm長ネジを3本外しています。

手順 12



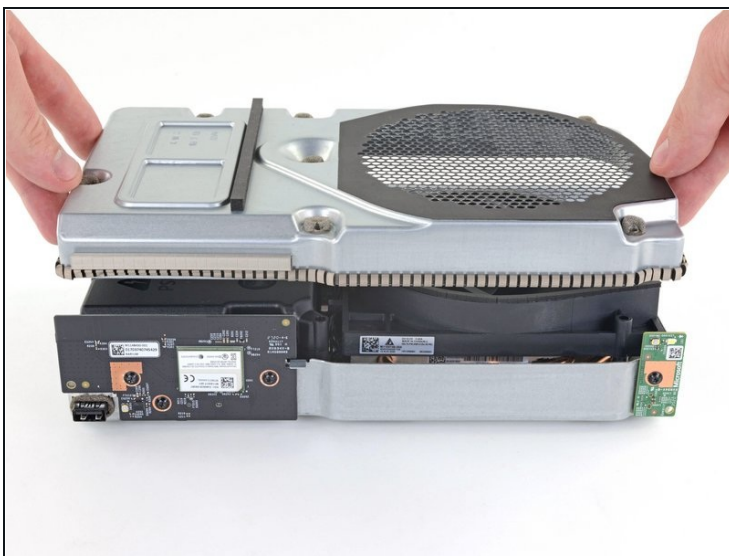
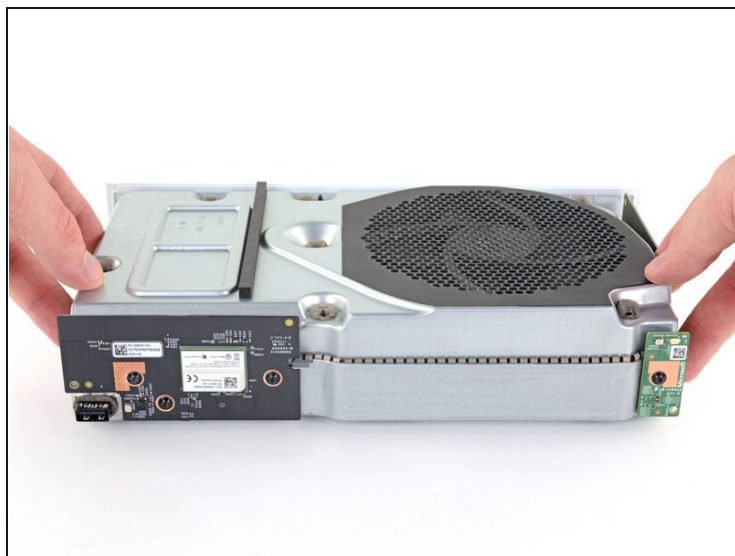
- スパッジャーを使って、Wi-Fiボードをこじ開けて緩めます。
⚠ Wi-Fiボードの底面もしくは側面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまう可能性があります。
- Wi-Fiボードをまっすぐ引き抜いて、シャーシから接続を外します。

手順 13 — 電源装置のネジを外します



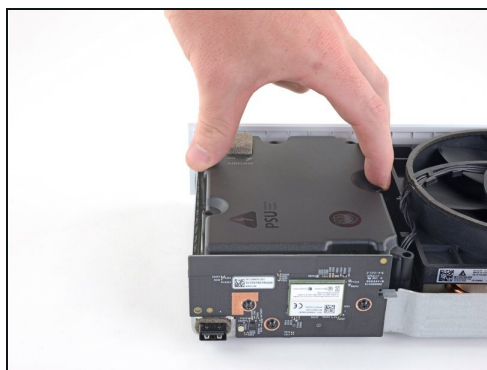
- T10トルクスドライバーを使って、シャーシに電源装置を固定している11.3mm長ネジを7本外します。

手順 14 — 上部シャーシを外します



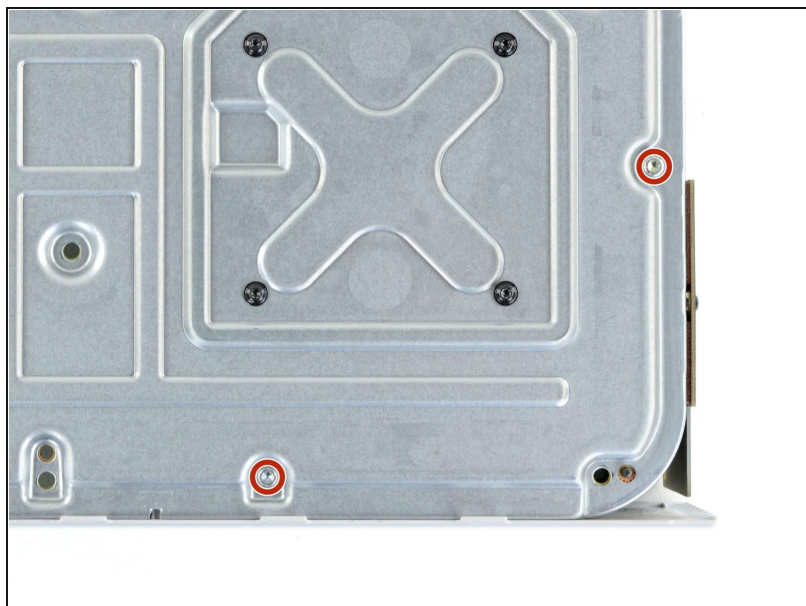
- デバイスを裏返します。
- 上部シャーシをまっすぐ持ち上げて、外します。

手順 15 — 電源を取り出します



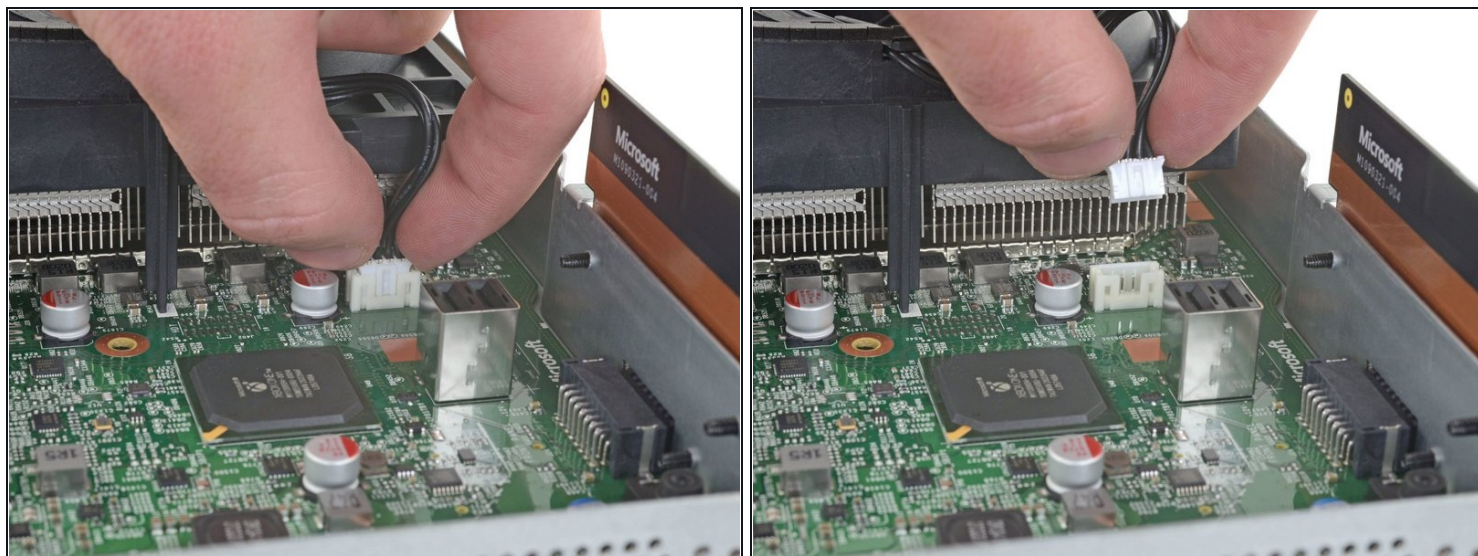
- 電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
- 電源を取り出します。

手順 16 — ファンのネジを外します



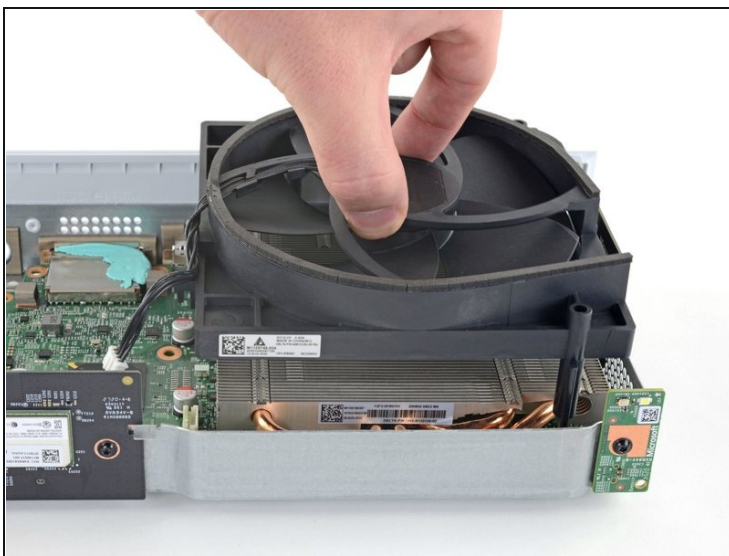
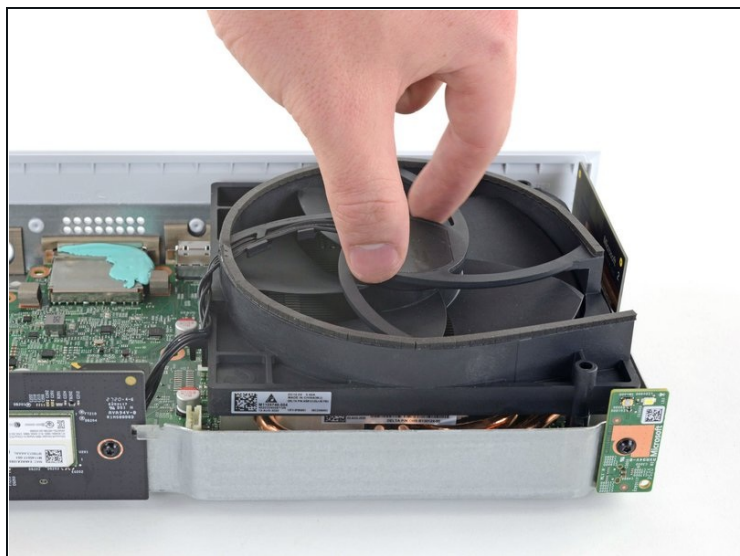
- T10トルクスドライバーを使って、シャーシにファンを固定している11.3mm長ネジを2本外します。

手順 17 — ファンの接続を外します



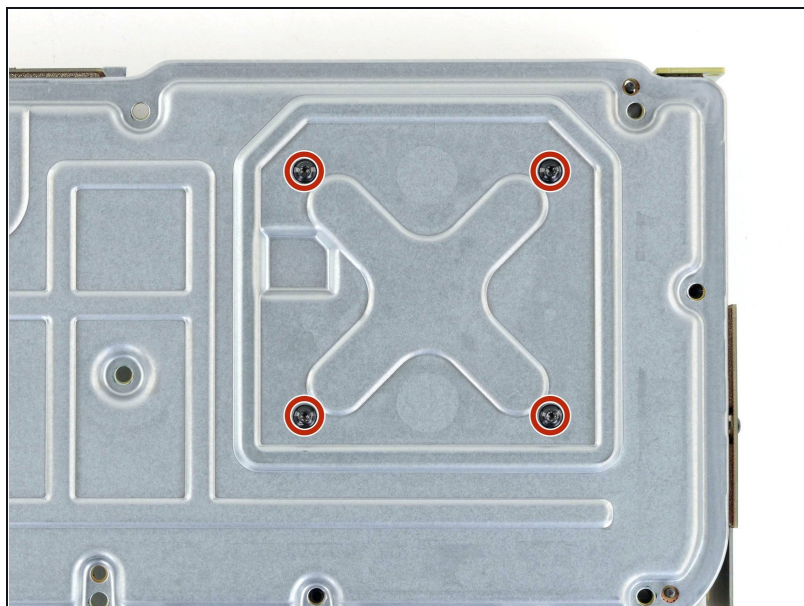
- デバイスを裏返します。
⚠️ ファンがゆるまってシャーシを裏返す際はご注意ください。
- 指先を使って、マザーボードのソケットからファンのコネクタを引き抜いて外します。
⚠️ ファンを取り外す際には、コネクタの破損を防ぐため、ワイヤ部分を引っ張らないようにご注意ください。
- ① このコネクタは外しにくい場合があります。良いやり方はスパッジャーでコネクタを持ち上げて、ソケットから外す方法です。
- ① ニードルノーズペンチを使えば、電源装置を外さずにこのコネクタを外すこともできます。

手順 18 — ファンを取り出します



- ファンをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから取り出します。

手順 19 — マザーボードのネジを外します



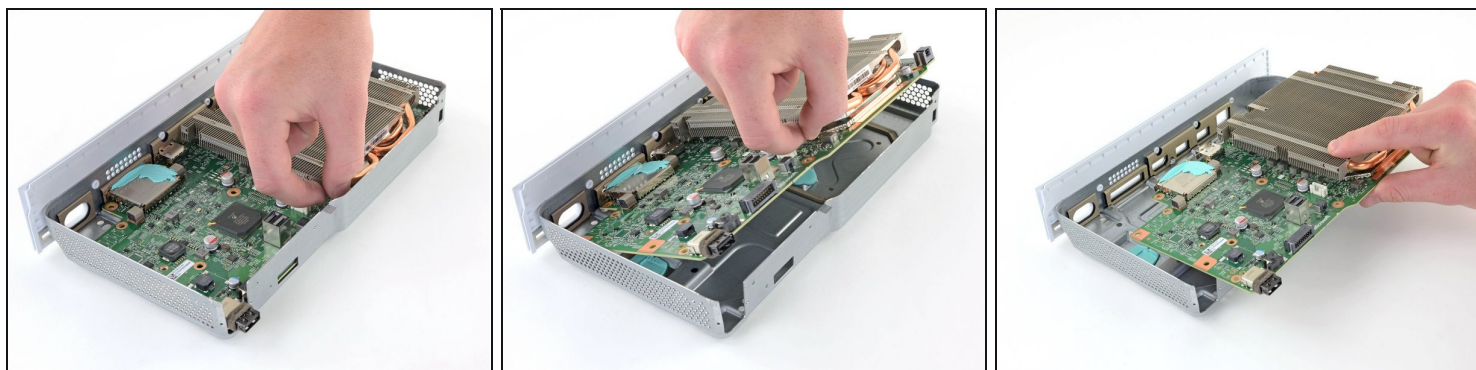
- T8トルクスドライバーを使って、マザーボードをシャーシに固定している9.4mm長ネジを4本外します。

手順 20 — ロッキングクリップを外します



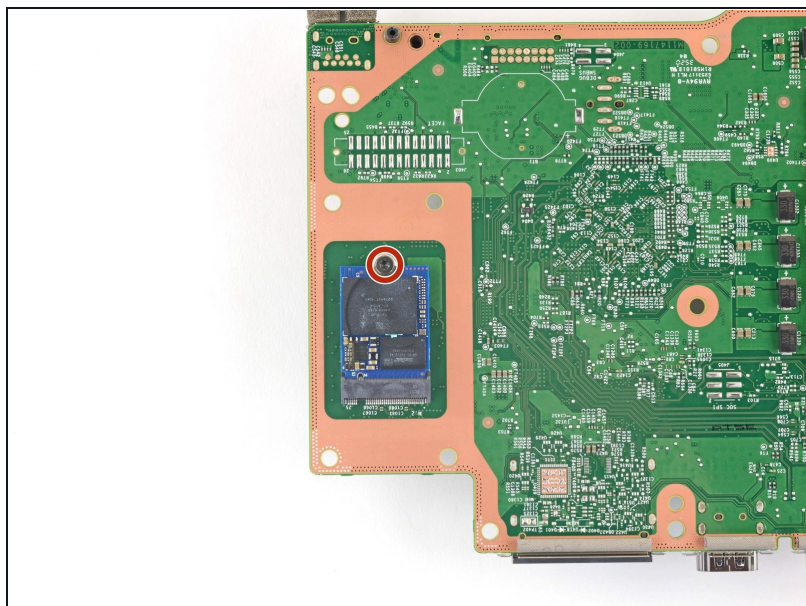
- デバイスを裏返します。
- スパッジャーをシャーシの正面左側コーナー上にあるロッキングクリップ内に差し込みます。
① この作業によりクリップが持ち上がり、取り外しやすくなります。
- クリップをまっすぐ持ち上げて取り出します。

手順 21 — マザーボードを取り出します



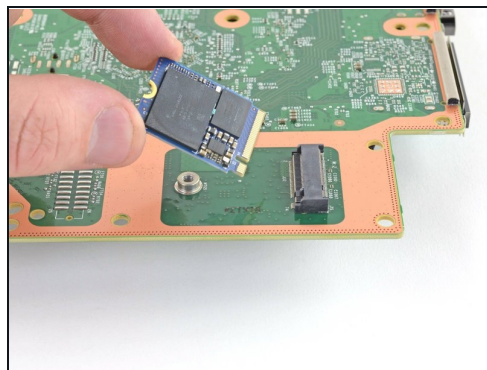
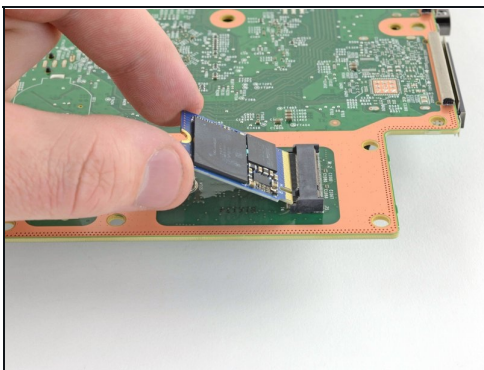
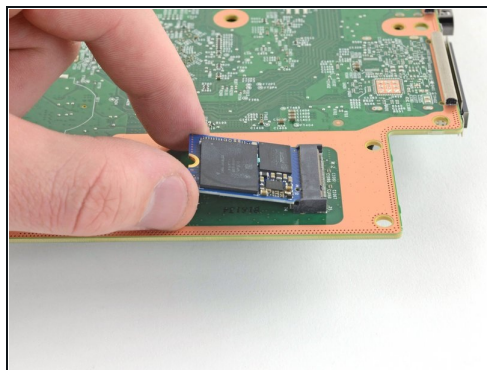
- ヒートシンクを指で摘んで、マザーボードの前面をシャーシの端より上に持ち上げます。
- マザーボードをシャーシの正面側に向けて引き抜いて、取り出します。

手順 22 — SSDカードを外します



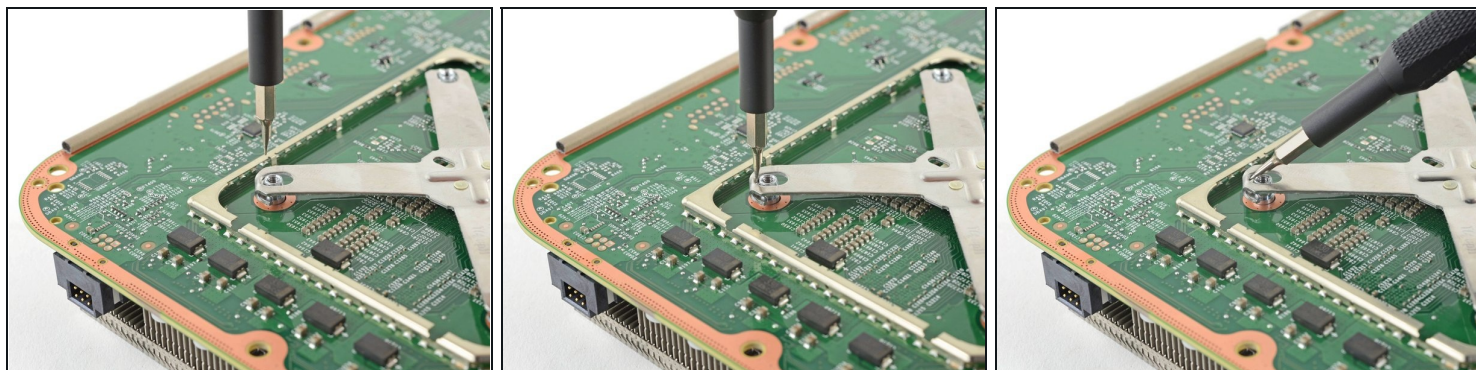
- T8トルクスドライバーを使って、SSDカードをマザーボードに固定している5.1mm長ネジを外します。

手順 23



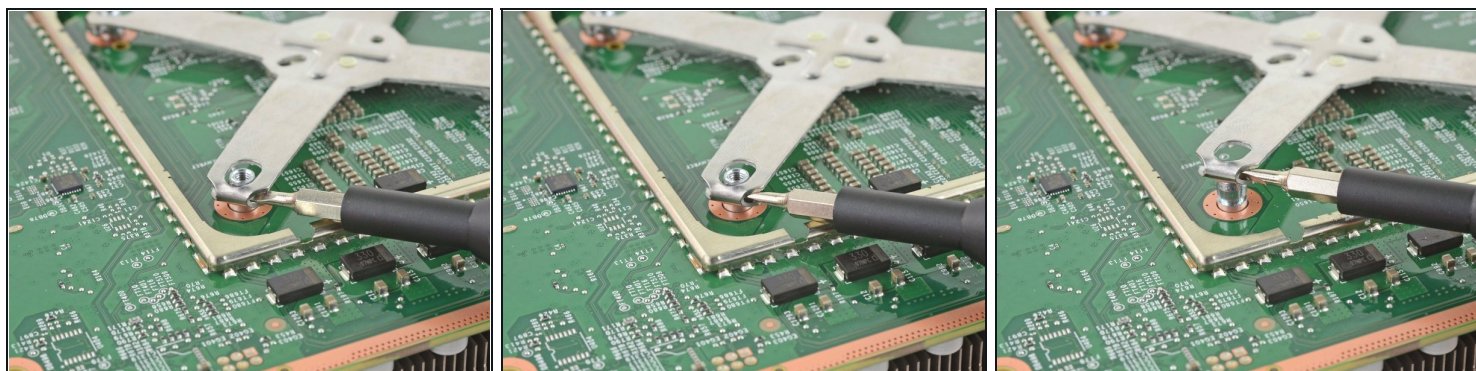
- SSDカードをまっすぐ引き抜いて、マザーボードから取り出します。

手順 24 — Xクランプを外します



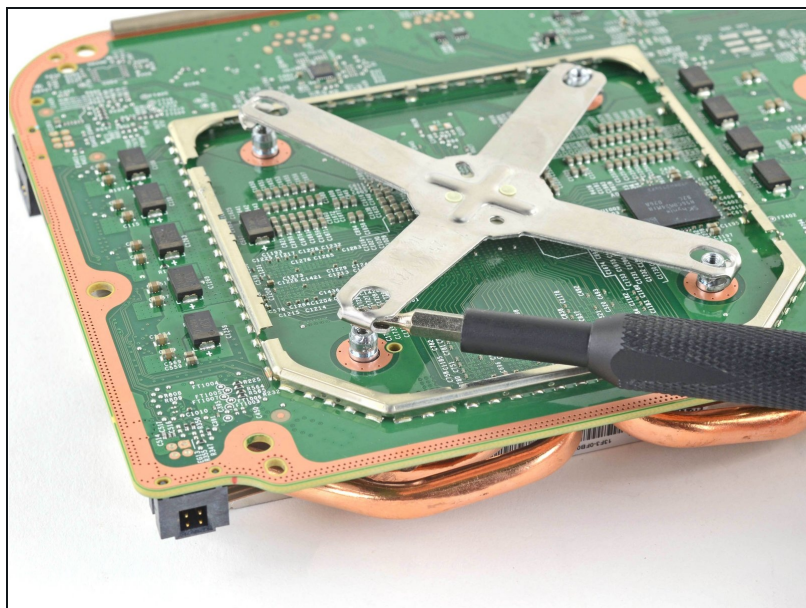
- 1.5mm マイナスドライバー をXクランプとヒートシンクピンの間に差し込みます。
- Xクランプをこじ開けて、ヒートシンクピンから外して、Xクランプを緩めます。
⚠ この方法でXクランプ全体を完全に外さないでください。

手順 25



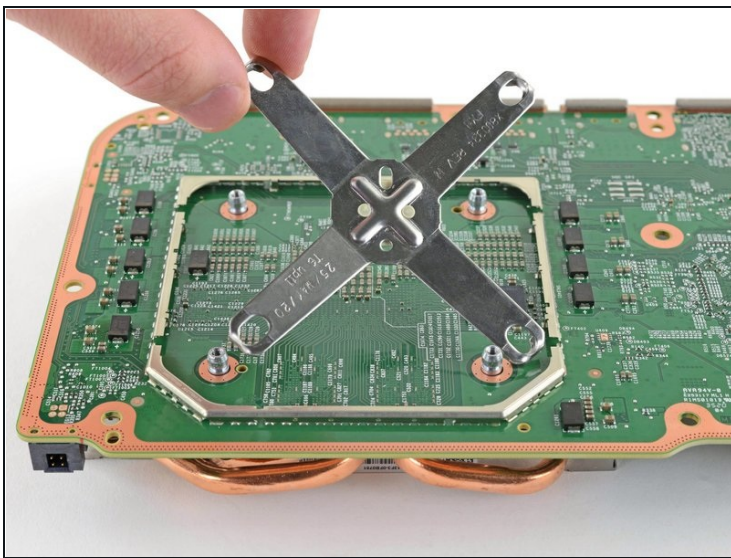
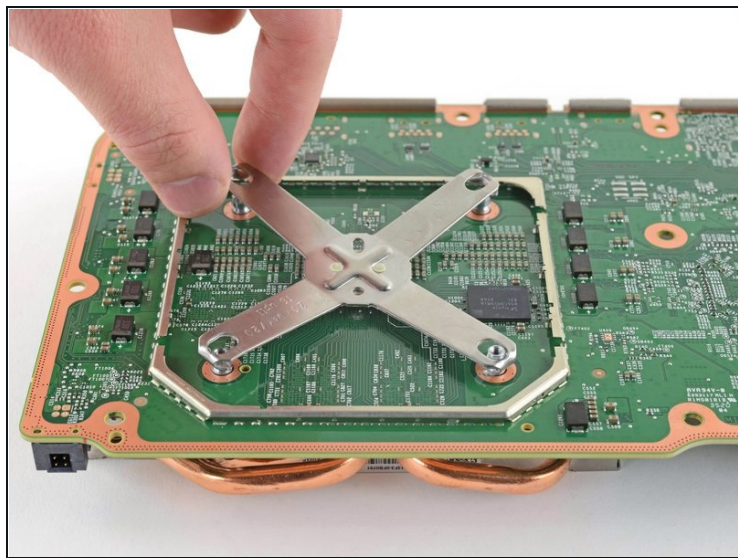
- ドライバーヘッドをマザーボードに対して水平にして、その先端をヒートシンクピンとXクランプのフック間の側面に差し込みます。
- マイナスドライバーを時計回りにねじって、ヒートシンクピンの溝からXクランプの下端をこじ開けます。
 - ① 作業がうまく進まない場合は、大型のマイナスドライバーを使用してください。
 - ① ねじるとXクランプがヒートシンクピンから飛び出します。出てこない場合は、前の手順を繰り返して再試行してください。

手順 26



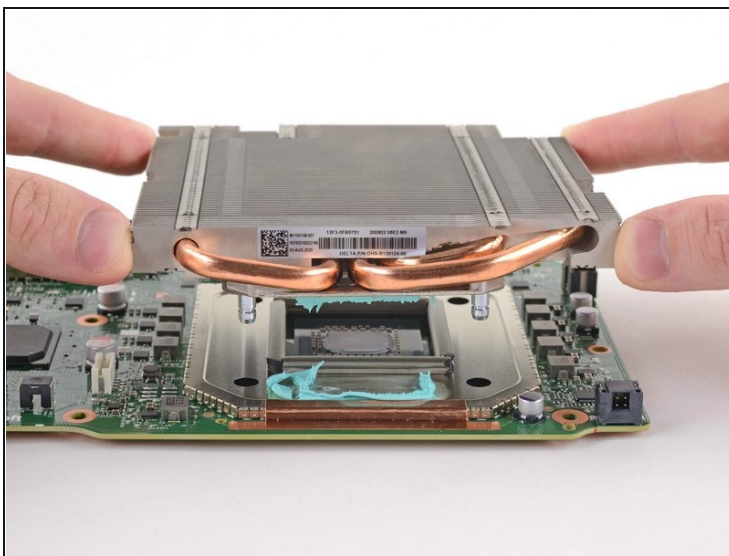
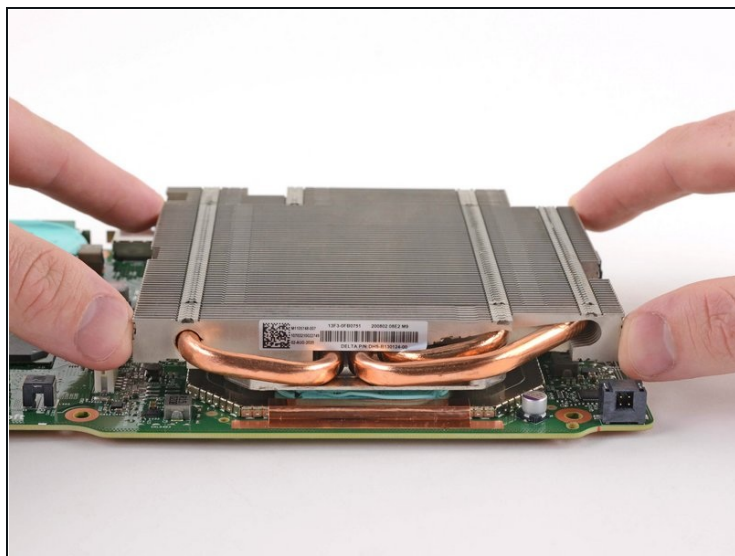
- Xクランプ全体が外れるまで、前の2つの手順で説明した手順ですべてのヒートシンクピンに同じ作業を続行します。

手順 27



- Xクランプを取り出します。
- ☒ Xクランプを再イントールする際は、Xクランプのフックをヒートシンクピンに押し込めば、2つから3つの側面を取り付けれるはずです。次にマイナスドライバーを使用して、ヒートシンクピンのXクランプフックをこじ開けます。

手順 28 — ヒートシンクを取り出します



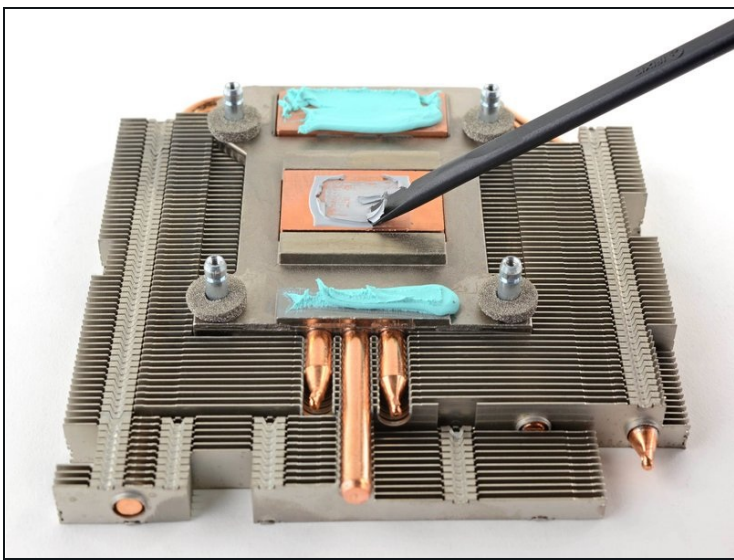
- マザーボードを裏返します。

⚠ ヒートシンクが飛び出すことがあるため、マザーボードを裏返す際はご注意ください。

- ヒートシンクをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから取り出します。

① コンソールがオーバーヒートする原因として一般的な理由の1つは、ヒートシンクの詰まりです。時間をかけて丁寧に、フィンの間の埃やごみを取り除いてください。

手順 29



- マザーボードを裏返します。
- 放熱グリスをプロセッサとシールドプレートに塗布する方法についてより詳細なガイドは[こちら](#)をご覧ください。
 - ✦ 通常の放熱グリスは、シールドプレートとヒートシンクの間の大きな隙間を埋めるように設計されていないため、K5Pro粘着性放熱グリスを使用してより厚いティールパテを作ります。ただし、APUには通常の放熱グリスを交換してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずは[ベーシックなトラブルシューティング](#)を試してみるか、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。